

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩指引情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

（二）业绩预告情况

（1）经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2024年半年度实现营业收入430,000.00万元至450,000.00万元，与上年同期相比，将增加133,033.41万元至153,033.41万元，同比增长44.80%至51.53%。

（2）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润15,000.00万元到22,000.00万元，与上年同期相比，将增加19,361.02万元到26,361.02万元，同比增长443.96%到604.47%。

（3）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,500.00万元到11,000.00万元，与上年同期相比，将增加22,119.79万元到25,619.79万元，同比增长151.30%到175.24%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023年半年度，公司实现营业收入296,966.59万元；归属于母公司所有者的净利润-4,361.02万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,619.79万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、随着行业景气度逐渐回升，公司产能利用率持续提升，自 2024 年 3 月份起产能持续维持满载状态，上半年整体销量实现快速增长，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

2、公司持续丰富晶圆代工领域产品结构，提升产品竞争优势及多元化程度。DDIC 继续巩固优势，CIS 成为公司第二大主轴产品，其他产品竞争力持续稳步提升。经财务部门初步测算，2024 年上半年 CIS 占主营业务收入的比例持续提高。中高阶 CIS 产品产能处于满载状态。

3、公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入。目前 55nm 中高阶单芯片及堆栈式 CIS 芯片工艺平台已大批量生产，40nm 高压 OLED 芯片工艺平台已实现小批量生产，28nm 芯片工艺平台研发正在稳步推进中。同时，公司积极配合汽车产业链的需求，已有部分 DDIC 芯片应用于汽车领域。

四、风险提示

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据。截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日